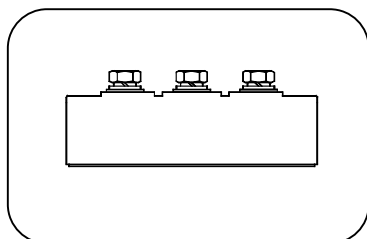


普通整流管模块

MDC200 MDA200 MDK200 MD200



特点:

- n 芯片与底板电气绝缘,3600V 交流电压
 - n 全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
 - n 体积小,重量轻
- 典型应用:
- n 交直流电机控制
 - n 各种整流电源
 - n 变频器

$I_{F(AV)}$	200A
V_{RRM}	600 ~ 3600V
I_{FSM}	8 KA
I^2t	326 $10^3 A^2S$

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			200	A
$I_F(RMS)$	方均根电流		150			314	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} tp=10ms$ $V_{RSM} = V_{RRM}+200V$	150	600		3600	V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM} = V_{RRM}$	150			16	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波,	150			8.00	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$				326	$A^2s \cdot 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.80	V
r_F	斜率电阻					0.96	mΩ
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=600A$	25			1.48	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦半波, 单面散热				0.220	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.08	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}: 1mA(max)$		3600			V
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量					320	g

普通整流管模块

MDC200 MDA200 MDK200 MD200

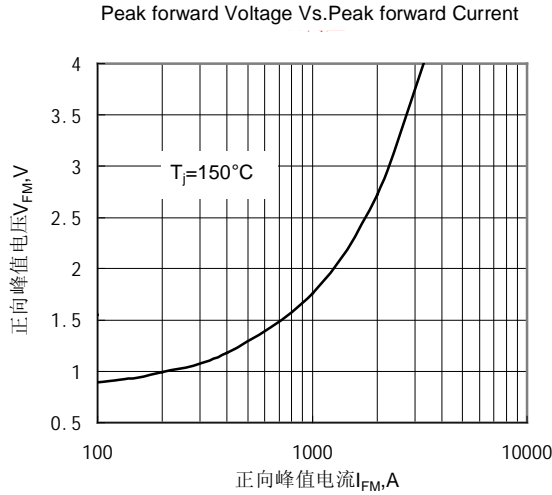


Fig.1 正向伏安特性曲线

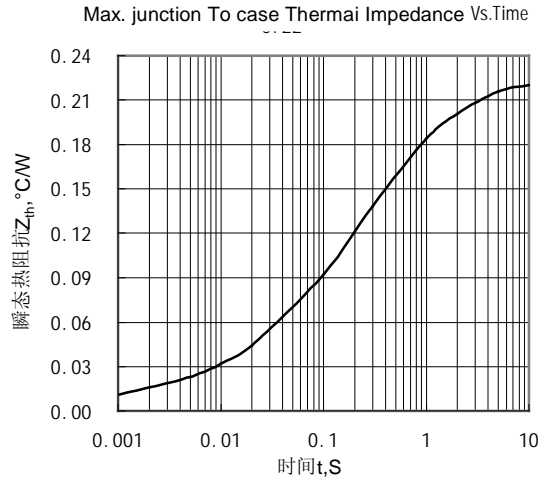


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

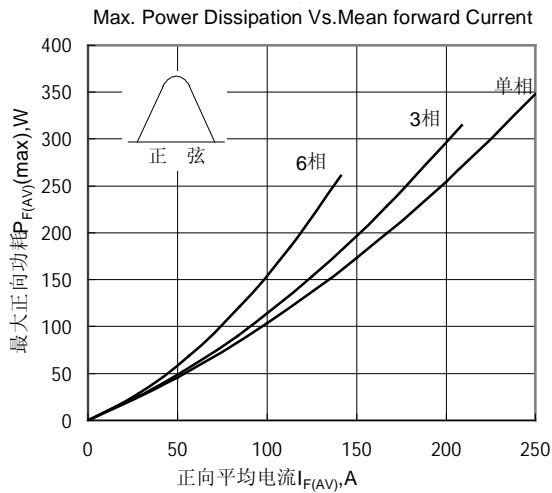


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

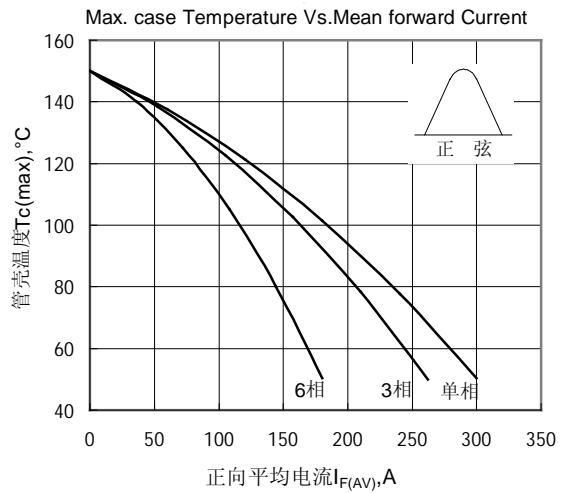


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

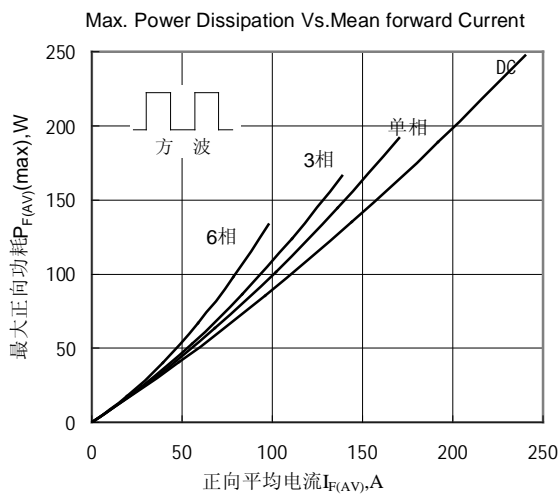


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

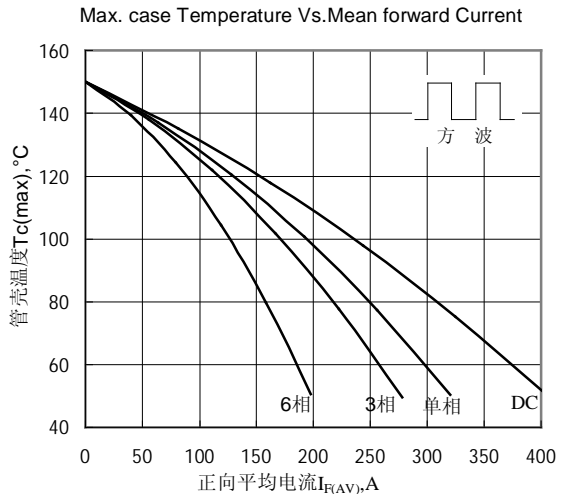


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

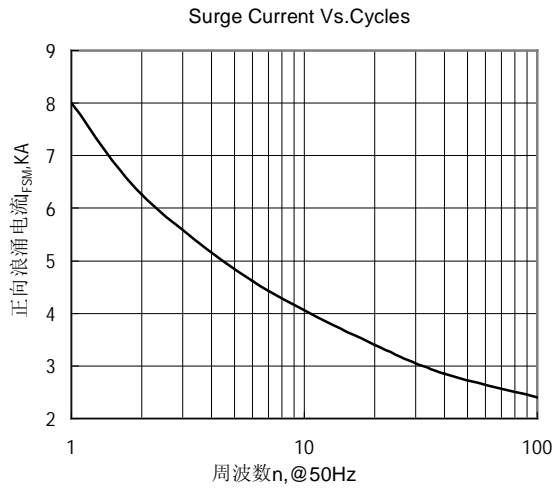


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

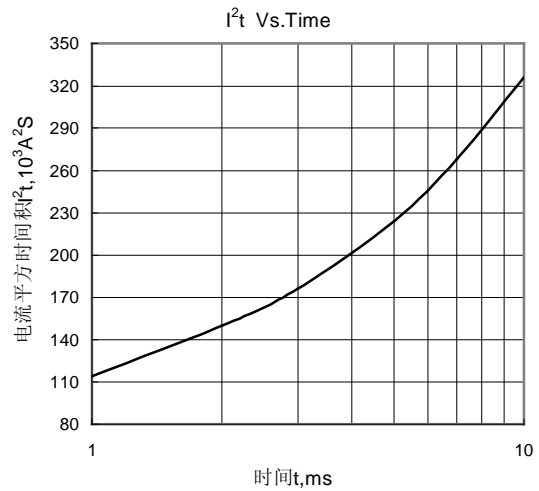


Fig.8 I²t特性曲线

外形图:

